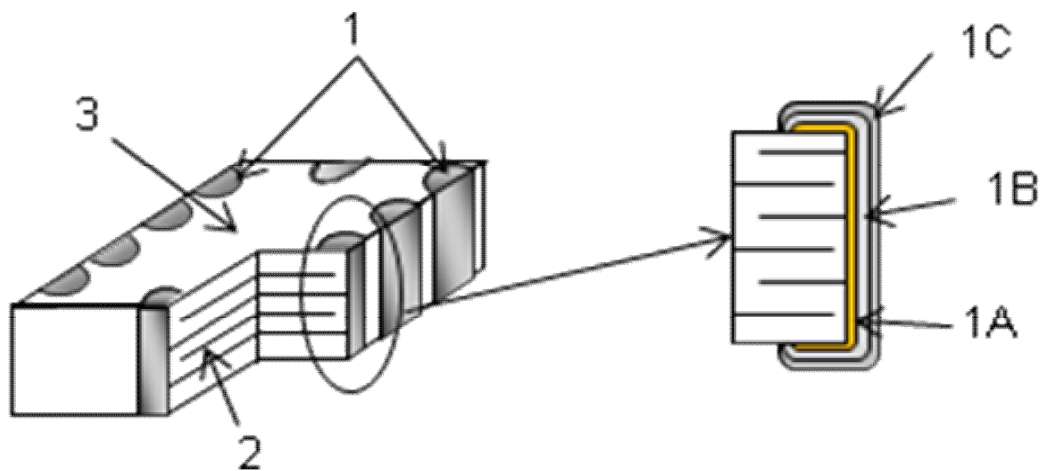


低 ESL 型チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<LLM Series>



No.	名称(Name)	材料(Material)
1	外部電極 (Termination)	1A 銅(Cu)
		1B ニッケルめっき(Ni plated)
		1C すずめっき(Sn plated)
2	内部電極(Inner electrode)	ニッケル(Ni)
3	誘電体素子(Dielectric layer)	チタン酸バリウム(BaTiO ₃)